



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113228243 A

(43) 申请公布日 2021.08.06

(21) 申请号 201980004188.8

(51) Int. Cl.

(22) 申请日 2019.12.03

H01L 21/67 (2006.01)

(85) PCT国际申请进入国家阶段日
2020.03.10

H01L 33/02 (2006.01)

H01L 33/48 (2006.01)

H01L 27/15 (2006.01)

(86) PCT国际申请的申请数据
PCT/CN2019/122819 2019.12.03

(87) PCT国际申请的公布数据
W02021/109010 ZH 2021.06.10

(71) 申请人 重庆康佳光电技术研究院有限公司
地址 402760 重庆市璧山区璧泉街道钨山路69号(1号厂房)

(72) 发明人 汪楷伦 许时渊 洪温振

(74) 专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202

代理人 熊永强

(54) 发明名称

一种半导体装置巨量转移方法和系统

(57) 摘要

一种半导体装置的巨量转移方法和系统,其中方法包括:提供形成于原生基板(100)的半导体装置(200);提供涂布有黏着层(30)的中转基板(10),黏着层(30)的粘性与温度大小成正比;将半导体装置(200)远离原生基板(100)的一侧与黏着层(30)粘贴以将半导体装置(200)粘贴于黏着层(30);从半导体装置(200)剥离原生基板(100),且在剥离过程中黏着层(30)温度增加;利用转移装置(20)抓取半导体装置(200)以使半导体装置(200)从中转基板(10)剥离;利用转移装置(20)将半导体装置(200)转移至目标基板(300),以将半导体装置(200)安装于目标基板(300)。

